

2025年2月12日

各 位

会 社 名 株式会社ジャパンディスプレイ
代表者名 代表執行役会長 CEO スコット キャロン
(コード番号 6740 東証プライム)
問合せ先 執行役員 CFO 平林 健
(TEL. 03-6732-8100)

先端半導体パッケージング及びセンサー技術を手掛ける PanelSemi Corporation (台湾) との資本業務提携のお知らせ

当社は、先端半導体パッケージングとセンサー技術を手掛ける PanelSemi Corporation (台湾、以下「PanelSemi」といいます。)との間で、JDIによる出資契約及び今後の協業に関する覚書(MOU)を締結いたしました(以下、これらを合わせて「本資本業務提携」といいます)ので、お知らせいたします。当社は今後台湾における外資企業の出資に関する当局の許認可を申請し、その承認が得られ次第、出資を実行する予定です。

1. 本資本業務提携の背景と目的

当社は、2024年11月13日付決算説明資料にて事業戦略「BEYOND DISPLAY」を発表いたしました。この戦略は、当社がディスプレイ事業で培ってきた有形・無形のアセットを活用し、センサー&ソリューション事業の拡大や、先端半導体パッケージング事業への参入を含めて新しい分野における事業展開をするものです。

本資本業務提携を通じて、当社は PanelSemi と協働し、先端半導体パッケージング用基板とセンサー事業を推進いたします。PanelSemiは、先端のセラミックベースの半導体パッケージングやセンサーにとって重要なフレキシブル電子部材における革新的な技術を有する企業です。

2. 本資本業務提携の概要

PanelSemiは、ディスプレイ由来のタイリング技術やTFT技術を保有し、ファブレス企業として先端半導体パッケージング用基板やセンサー技術等の開発・販売を行っています。

AIの急速な発展に伴い半導体パッケージングへの注目が高まっており、先端半導体パッケージングは2034年までに年間20兆円規模の巨大なグローバル市場に成長すると予想されています。AI半導体ではロジックとメモリの間で膨大なデータ量を扱うため、消費電力の増加とそれに伴う発熱が既存の有機基板の耐熱性を超過しつつあり、またチップレット形態の半導体の増加による基板サイズの拡大への対応が課題となっています。

今般、当社と PanelSemi は、両社のディスプレイ由来技術を活用して半導体パッケージング用セラミック基板とセンサー用フレキシブル基板を共同で開発し、事業化を進めることで合意するとともに、両社の関係性を強化するためにJDIがPanelSemiに出資することで合意いたしました。今後は、両社の知見とエンジニアリングリソースを活用して、事業化に向けた取り組みを実施いたします。日本での開発・生産活動は、今後生産を集約しMULTI-FAB工場となる石川工場にて展開いたします。

特に先端半導体パッケージング分野においては、当社とPanelSemiは、ディスプレイ技術で培ってき

た高密度配線技術と薄膜・ガラス加工技術を活用し、ガラスをキャリアとした有機インターポーターの形成や、コア基板としての平坦性や熱膨張差の課題を解決するセラミック基板を開発いたします。さらに、優れた材料特性を持つセラミック基板に、革新的なプロセスを用いて今までにない特性と機能性を提供いたします。また、当社独自の試作から量産につなげる豊富な生産技術と、グローバルな顧客に対する安定供給を可能にする信頼が高く、盤石なサプライチェーンを活かし、PanelSemiとのシナジーを最大化いたします。これにより、高品質で低コストの次世代半導体製品を提供し、急速に拡大する半導体パッケージング市場をリードしてまいります。

3. PanelSemi の概要

(1) 名称	PanelSemi Corporation (現地法人名：方略電子股份有限公司)
(2) 所在地	15F., No.207, Sec.3, Beixin Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231632, Taiwan
(3) 代表者の役職・氏名	董事長/総経理 丁景隆 (Ting Chin Lung)
(4) 事業内容	先端半導体パッケージング用基板、センサー等の開発・販売
(5) 設立年月日	2021年3月26日
(6) 当社との関係	資本関係：該当事項はありません 人的関係：該当事項はありません 取引関係：該当事項はありません

4. 今後の見通し

本資本業務提携による当期連結業績への影響は軽微ですが、中長期的に当社の収益力向上に大きく貢献するものと考えております。

以 上